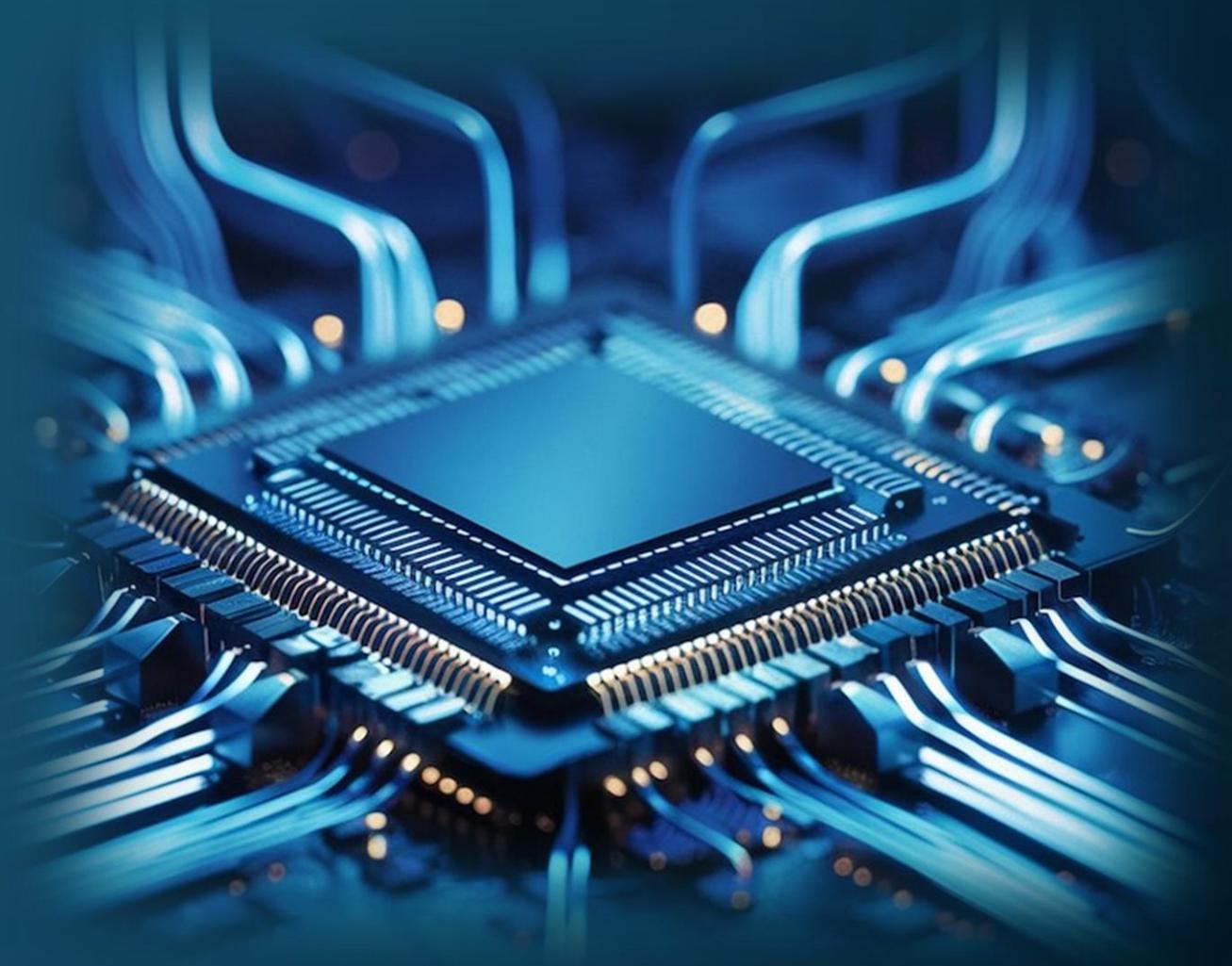




PRIORTECH

מצגת שוק הון

נובמבר 2025



בין השאר בשל הטלת מגבלות תנועה וסגרים בטריטוריות בהן פועלות החברה ו/או החברות המוחזקות שלה; (ב) תלות בצדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות שלה; (ג) התפתחויות רגולטוריות ומדיניות ממשלתית, בעיקר בשל פעילותן חברות הקבוצה בטריטוריות ברחבי העולם ובעיקר במזרח אסיה; (ד) חוסר יציבות באזורי פעילות גלובלית והשפעת משברים פוליטיים, כלכליים וגאו-פוליטיים על תעשיית המוליכים למחצה והמתח בין ארה"ב לבין סין; (ה) ההיצע העולמי של רכיבים אלקטרוניים ויכולתן של החברות המוחזקות לרכוש רכיבים אלקטרוניים לצורך שימור היתרון התחרותי שלהן; (ו) גידול בעלויות תפעוליות; (ז) עלויות ייצור גבוהות של לקוחות אשר עלולות להביא לעיכוב ברכישת מוצרים של החברות המוחזקות; (ח) גורמי הסיכון המפורטים בדוח השנתי של החברה לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 27.3.2025 (מספר אסמכתא -01-2025-021079).

לפיכך, תוצאות או ביצועים עתידיים בפועל של החברה או החברות המוחזקות שלה עשויים להיות שונים מהותית מכפי שנצפה או כפי שמתפרש במצגת זו.

למעט כפי שיידרש על פי דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מצגת זו ו/או לעדכן ו/או לשנות נתונים ו/או תחזיות ו/או הערכות שנכללו בה על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

חלק מהמידע הכלול במצגת (כולל שווקים ומגמות) מבוסס או נגזר מנתונים שהחברה אספה מצדדים שלישיים בלתי תלויים שהחברה אינה יכולה לערוך לנכונותם היות ולא בדקה את הנתונים בעצמה.

כמו כן, מובהר כי אין בביצועי העבר של החברה ו/או החברות המוחזקות שלה המוצגות במצגת זו כדי להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד ואין כל וודאות כי החברה ו/או החברות המוחזקות שלה יגיעו לתוצאות דומות או יוכלו ליישם את אסטרטגיית ההשקעה שלהן או להשיג כל יעד השקעה.

מטרת מצגת זו לספק אינפורמציה בלבד בנוגע לחברת פריורטק בע"מ ("החברה") ו/או החברות המוחזקות שלה.

מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה או איזה מהחברות המוחזקות שלה. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה.

המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים. על כן, מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכלל זה, בתשקיף מדף, בדוחותיה העיתיים של החברה או בדיווחיה המיידים של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה יגבר האמור בדיווחים האמורים.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים, כוונות ונתונים נוספים המתייחסים לאירועים עתידיים המהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף 32א בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, המבוסס על תחזיות, ציפיות והנחות סובייקטיביות כפי שידועות לחברה במועד הכנת מצגת זו. ההערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, ויכול שתושפענה מגורמים שאינם בשליטת החברה ושלא ניתן להעריכם מראש באופן סביר במועד, לרבות אבל לא רק, בשל: (א) האטה בצמיחה הכלכלית ככלל והאטה בפעילות בשווקי האלקטרוניקה והשבבים בפרט, עיכובים בשרשרת האספקה ועלויות מחירי הובלה, עלויות במחירי חומרי גלם, הפרעות ועיכובים בהתקנות של המוצרים באתרי לקוחות, עיכובים והפרעות לתהליכי ייצור, שיווק ומחקר ופיתוח, וכן הפרעות ועיכובים בייצוא או ייבוא של רכיבים ומוצרים,

YTD- 25
\$36.0M

Q3-25
\$17.5M

רווחי
אקוויטי

YTD- 25
\$30.0M

Q3-25
\$15.5M

רווח
נקי

חוב פיננסי, נטו
\$48.8M

הון עצמי
\$256M

תחזית שוק הסמיקונדקטור

אנליסטיים מעריכים שתעשיית הסמיקונדקטור תמשיך לגדול בשנים הקרובות ותגיע להיקף מכירות של טריליון דולר עד סוף העשור

המכירות העולמיות בענף הסמיקונדקטור גדלות בשנת 2025; תחזית האנליסטים היא להיקף של כ- 700 מיליארד דולר השנה. מגמת הגידול צפויה להמשך בשנת 2026 עם תחזיות של כ- 760-800 מיליארד דולר מכירות.

רכיבי ה- HPC ורכיבי ב- Advanced Packaging מהווים את המנוע העיקרי לצמיחה בשוק, בעיקר עקב התרחבות השימושים של יישומי AI והדרישה לרכיבי חומרה מתאימים לחוות שרתים ולמחשוב קצה יעודי.

ממשלות ברחבי העולם משקיעות בבניית יכולות יצור מקומיות, בהבטחת שרשרת אספקה ובהקטנת תלות בגורמים חיצוניים.

הגבלות יצוא, מתיחות פוליטית (בעיקר ארה"ב-סין) ותלות בחומרי גלם, ממשיכים להוות סיכון בשוק. ארה"ב השעתה חלק ממדיניות התעריפים החדשה שלה, אולם הדבר עדיין מהווה גורם סיכון משמעותי.

הביקוש בסגמנט מוצרי הצריכה (בעיקר טלפונים ומחשבים אישיים) עדיין נמוך ותנודתי ומעיב על הצמיחה בשוק.



תיאור המצב העסקי של החברות הכלולות



Camtek
See Beyond

ACCESS



PRIORTECH



 **ACCESS**

AMITEC/ACCESS

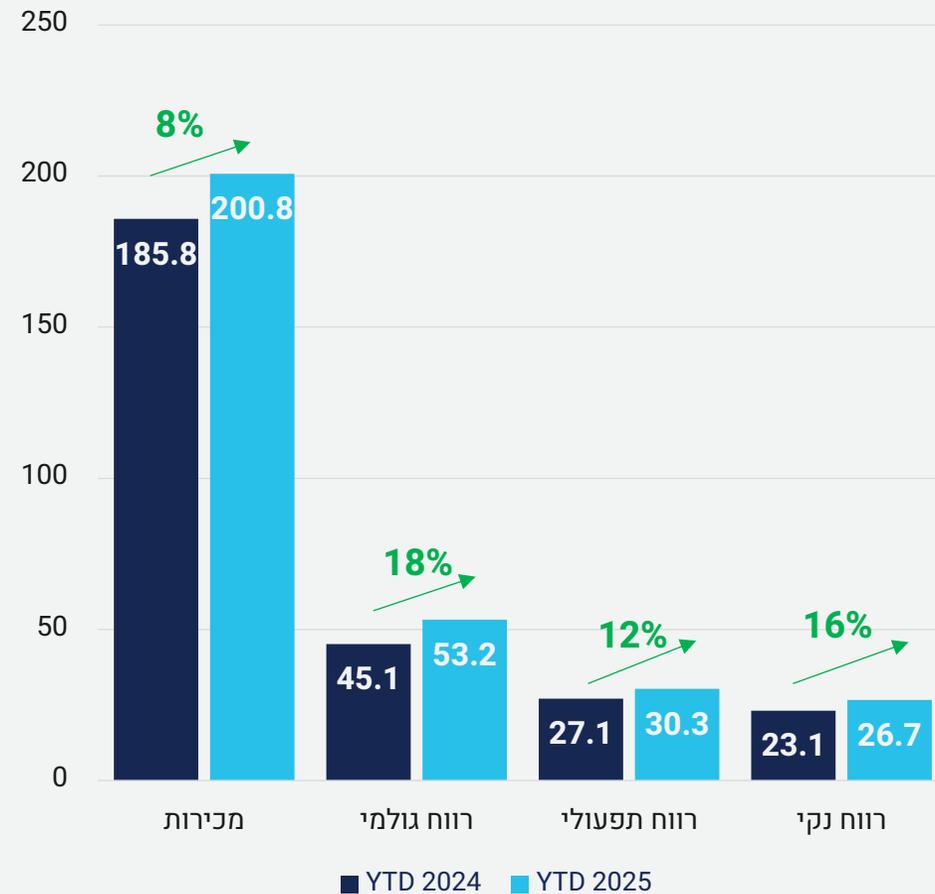
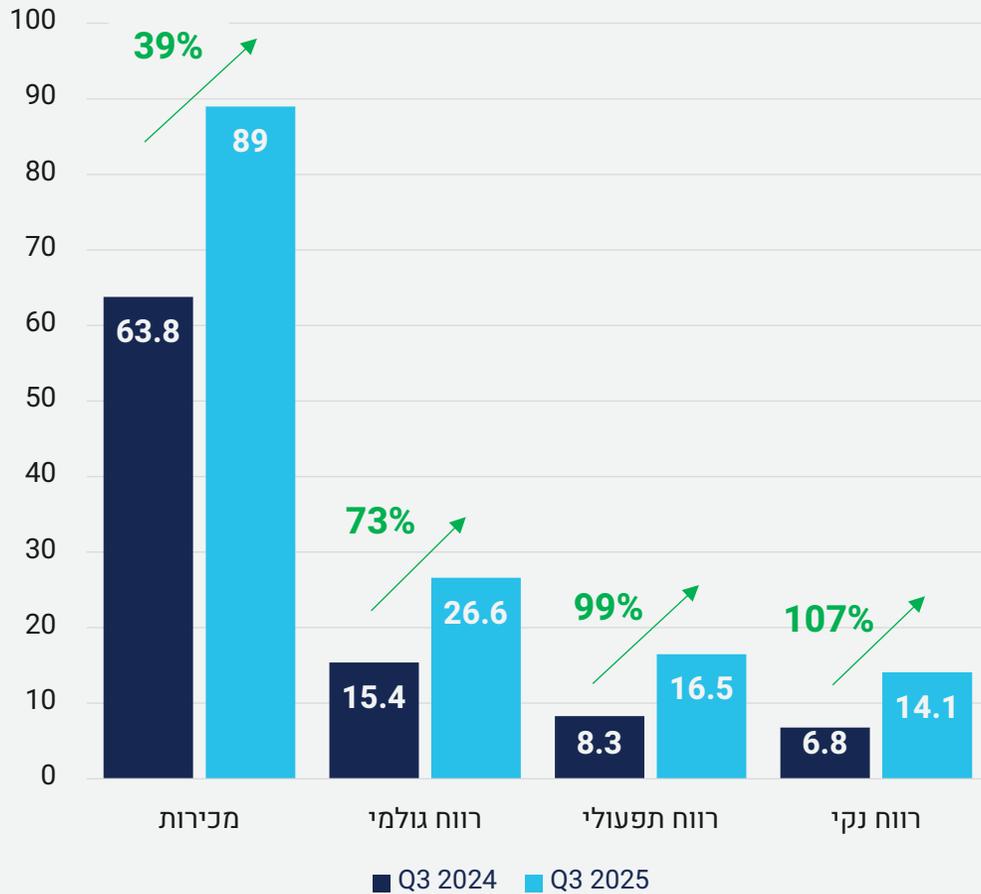
שנת 2025 צפויה להיות **שנת שיא** של אקסס עם **צפי מכירות שנתי של כ- 288 מיליון דולר** לצד שיפור מתמשך ברווחיות במשך השנה. אקסס מעריכה כי מגמת הצמיחה תימשך גם בשנת 2026. אקסס מבססת את מעמדה כאחת **השחקניות המובילות** בשוק הרכיבים **למחשבי HPC המיועדים ליישומי AI**.

תחום **רכיבי ה- Power Device** הפך להיות **תחום משמעותי ומוביל** באקסס, בעיקר בזכות הביקושים לרכיבים המשולבים **במחשבי ה- HPC**, המשמשים בעיקר ב- **Data centers ליישומי AI**. תחום זה אחראי ל- **34%** ממכירות אקסס השנה.

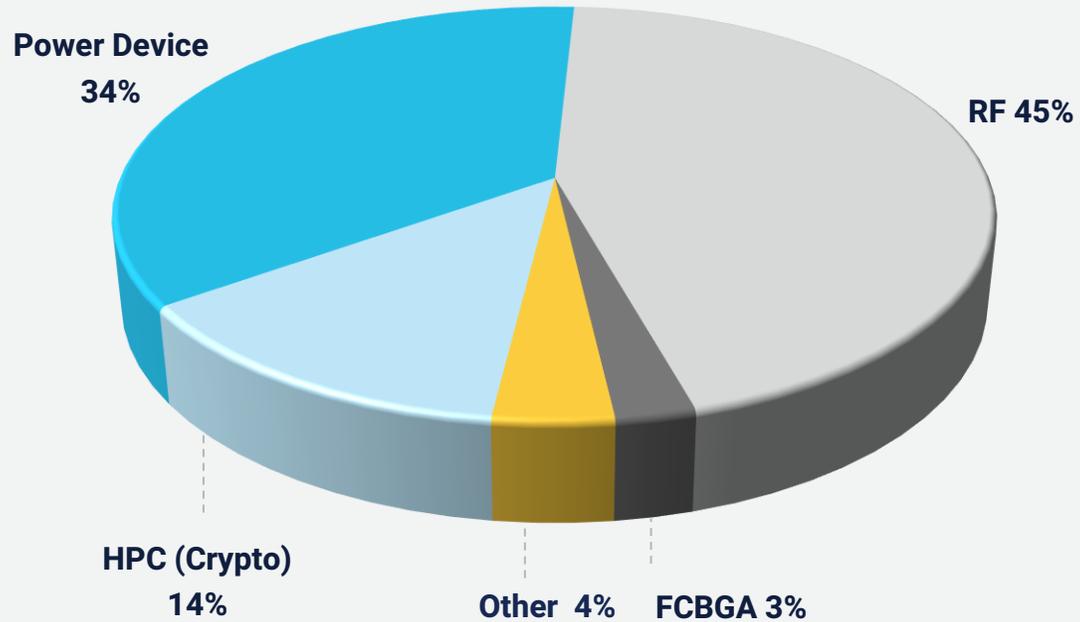
תחום מצעי ה- HPC עבור יישומי **מטבעות וירטואליים** גדל ברבעון השלישי. למיטב ידיעת אקסס, חלק מהלקוחות הסופיים של תחום זה **דורשים** מהספקיות הטאיוואניות להמשיך **ולעבוד עם מצעי ה- HPC של אקסס**.

תחום **רכיבי ה- RF** סובל עדיין **מהמיתון בסין** ומהביקושים הנמוכים למוצרי צריכה, אולם רשם שיפור במכירות ועדיין מהווה את **תחום הפעילות העיקרי** האחראי ל- **45%** מהמכירות.

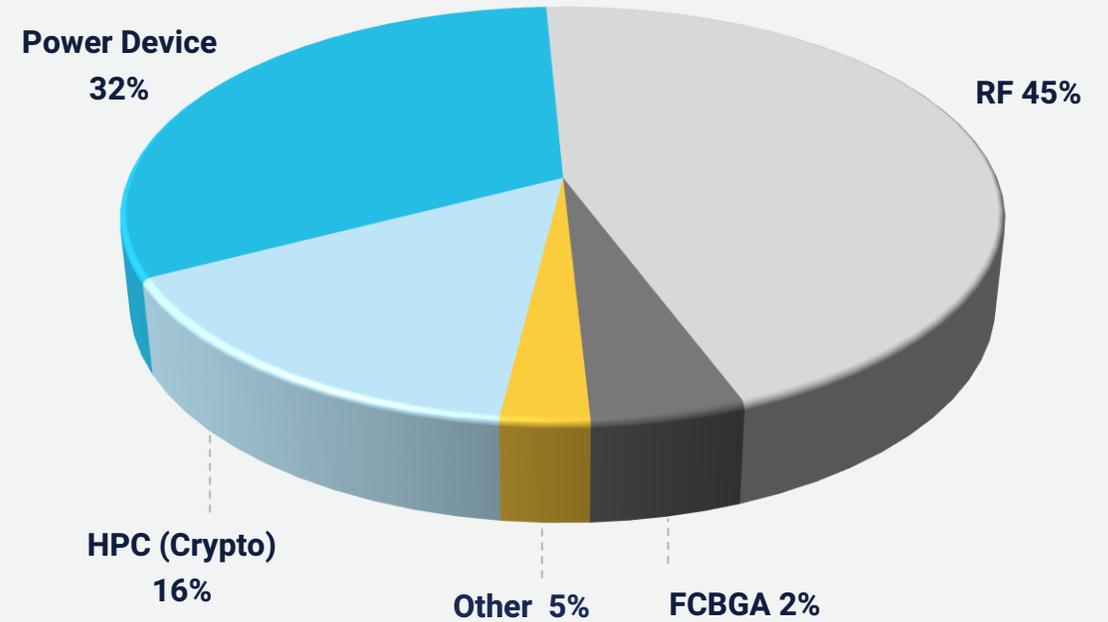
אקסס הגישה את הבקשה לרישום למסחר בבורסה בשנזן, בסוף חודש ספטמבר 2025. היא צפויה לעבור בדיקה מקיפה של הרגולטור הסיני, המוערכת בכשנה, לצורך קבלת האישור לרישום.



YTD 2025 REVENUE



Q3 2025 REVENUE



Camtek



CAMTEK



המצב העסקי של קמטק

קמטק צופה שתחום הרכיבים עבור המחשבים עתירי הביצועים ה-**HPC** ימשיך להיות **מנוע הגידול העיקרי** של קמטק. כיום קמטק היא ספק ציוד מוביל בפתרונות לשוק זה.



צפי המכירות לרבעון הרביעי של 2025 עומד על כ-127 מיליון דולר, שנת 2025 תהיה שנת שיא ותסתיים במכירות של כ-495 מיליון דולר.

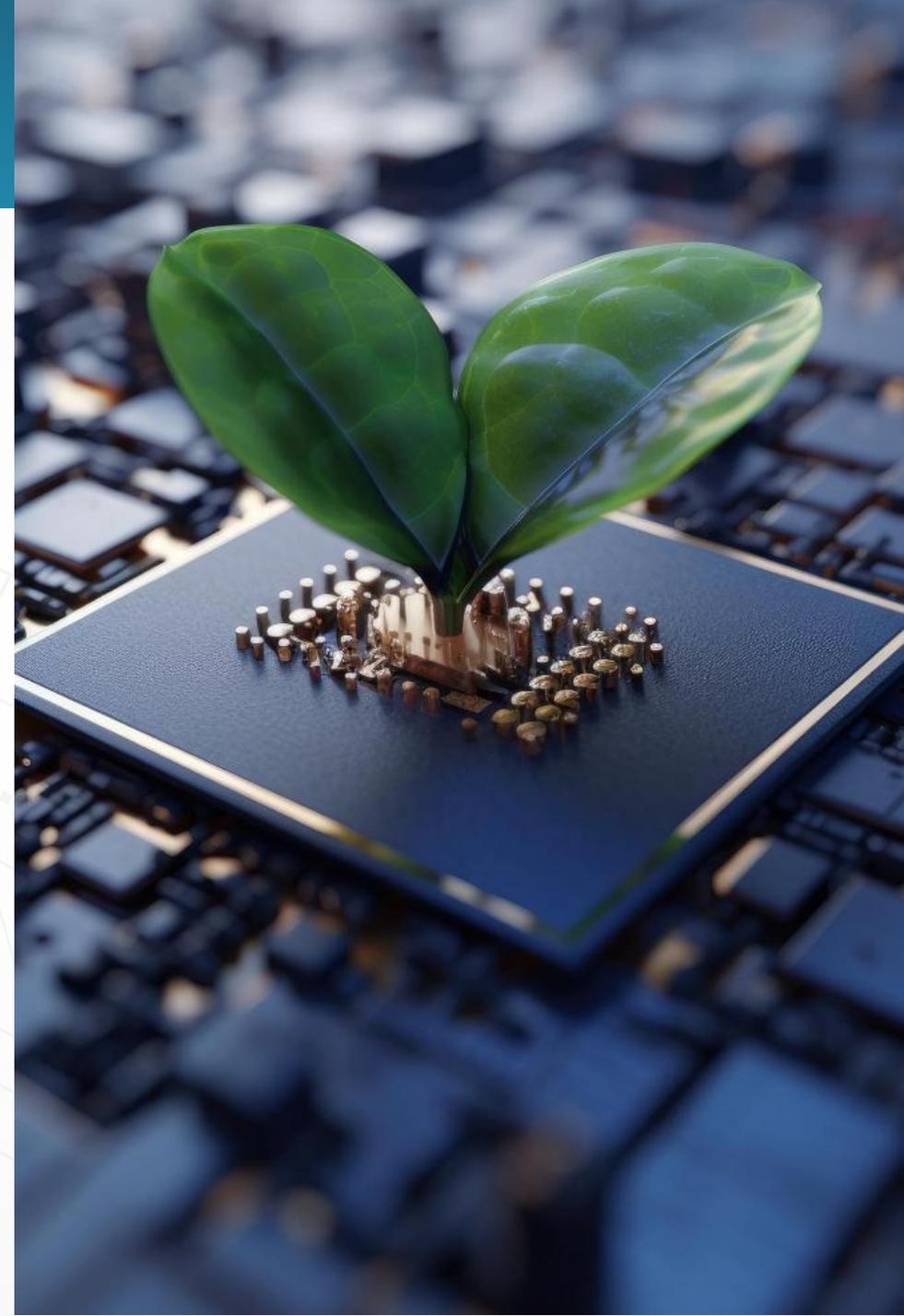
הדגמים החדשים - Hawk ו-Eagle G5 – שהשיקה קמטק, מציגים ביצועים גבוהים בהשוואה למערכות הקודמות שלה וצפויים לתרום כ-30% מהמכירות שלה בשנת 2025.



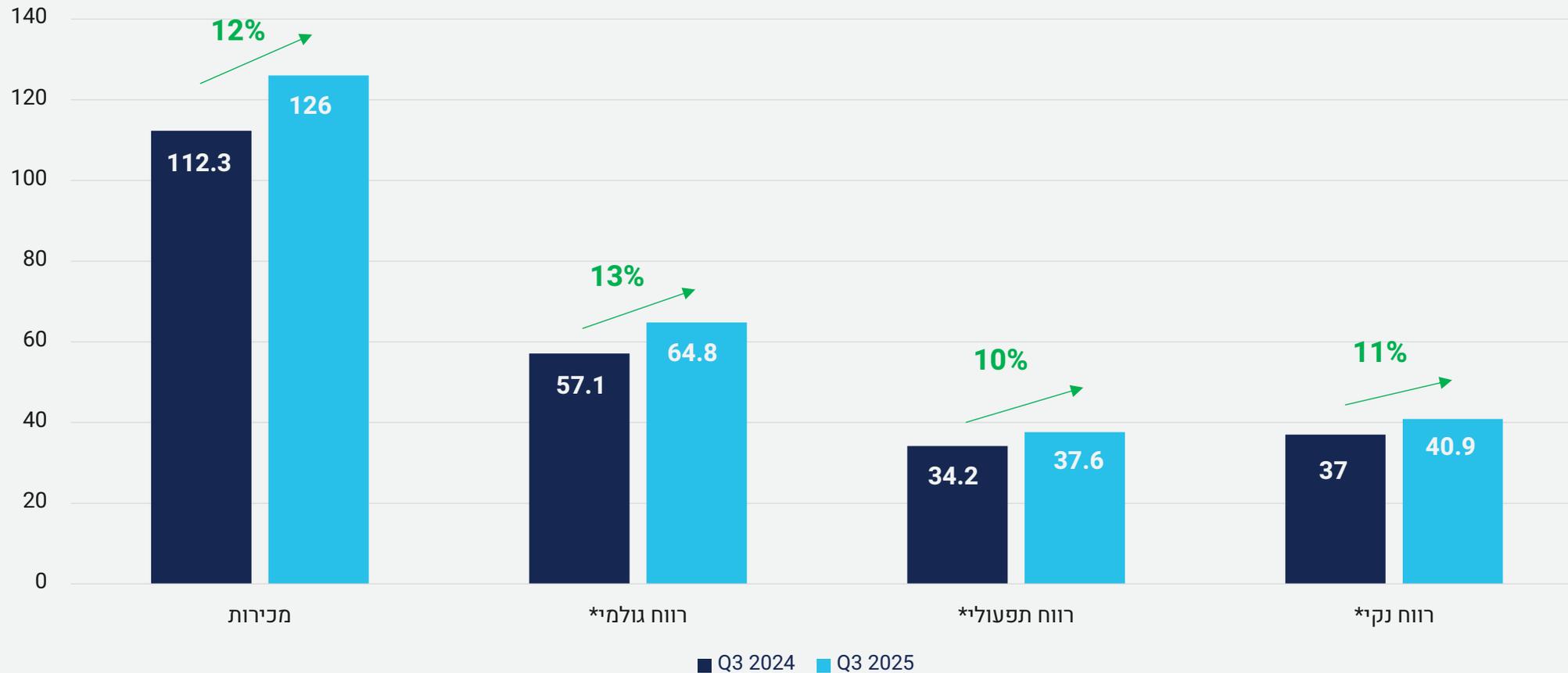
קמטק מתכננת להשיק גרסה משופרת של ה-Hawk בחצי הראשון של השנה הבאה, שתכלול שיפורים משמעותיים בביצועים הכוללים של המערכת. שיפורים אלה צפויים לחזק יותר את מעמד ה-Hawk כמערכת מתקדמת ביותר בקטגוריה שלה.



בספטמבר 2025, ביצעה קמטק הנפקת אג"ח מוצלחת בסך 500 מיליון דולר ויתרת הנכסים הפיננסיים שלה עומדת על כ-800 מיליון דולר ומספקת לה גמישות פיננסית גבוהה להמשיך בצמיחה אורגנית, וכן לבחון הזדמנויות לצמיחה אנאורגנית בשווקים בהם היא פועלת.



קמטק - תוצאות רבעון שלישי 2025





קמטק ביססה את מעמדה כמובילה עולמית בתחום בדיקת הרכיבים למחשבים עתירי הביצועים (HPC) המיועדים לאפליקציות AI, אחד התחומים הצומחים והמרתקים בעולם הטכנולוגיה.

קמטק מאמינה שטכנולוגיות המארגים החדשות Hybrid bonding and micro copper bumps, תהווה עבור קמטק הזדמנויות צמיחה משמעותיות בשנים הקרובות.



אקסס היא החברה המובילה בסין בתחום המצעים המתקדמים, ומבססת את מעמדה כשחקנית חשובה בשוק ה-HPC ליישומי AI.

מנוע הצמיחה המרכזי של אקסס הוא תחום המארגים המתקדמים ל- Power Devices (ECP). מארגים אלו מותקנים במחשבי ה-HPC של החברות המובילות בעולם, המשמשים להרצת אפליקציות של AI.

מונחים מקצועיים

הגדרות

(HPC) High Performance Computer

מחשבים חזקים במיוחד כדי לפתור בעיות חישוב מתקדמות, המתבססים על מארזים מתקדמים מסוג Chiplet או Heterogeneous Integration שתומכים בישומי AI וכוללים זיכרונות DRAM מסוג HBM שהם 8 שכבות של ציפים מסוג Dram שמורכבים אחד על השני.



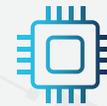
(HI) Heterogeneous Integration

אינטגרציה של רכיבי סמיקונדקטור המיוצרים בנפרד במכלול ברמה גבוהה יותר, אשר, במצטבר, מספקת פונקציונליות משופרת ומאפייני פעולה משופרים.



Chiplet

ציפלט הוא יחידת עיבוד משנית, הנשלטת בדרך כלל על-ידי בקר קלט/פלט הנמצא באותו מארז. ארכיטקטורת הציפלט היא גישה מודולרית לבניית מעבדים. אינטל ו-AMD, יצרני המעבדים המובילים בעולם, מאמצים את ארכיטקטורת הציפלט לקו המוצרים הנוכחי שלהם.



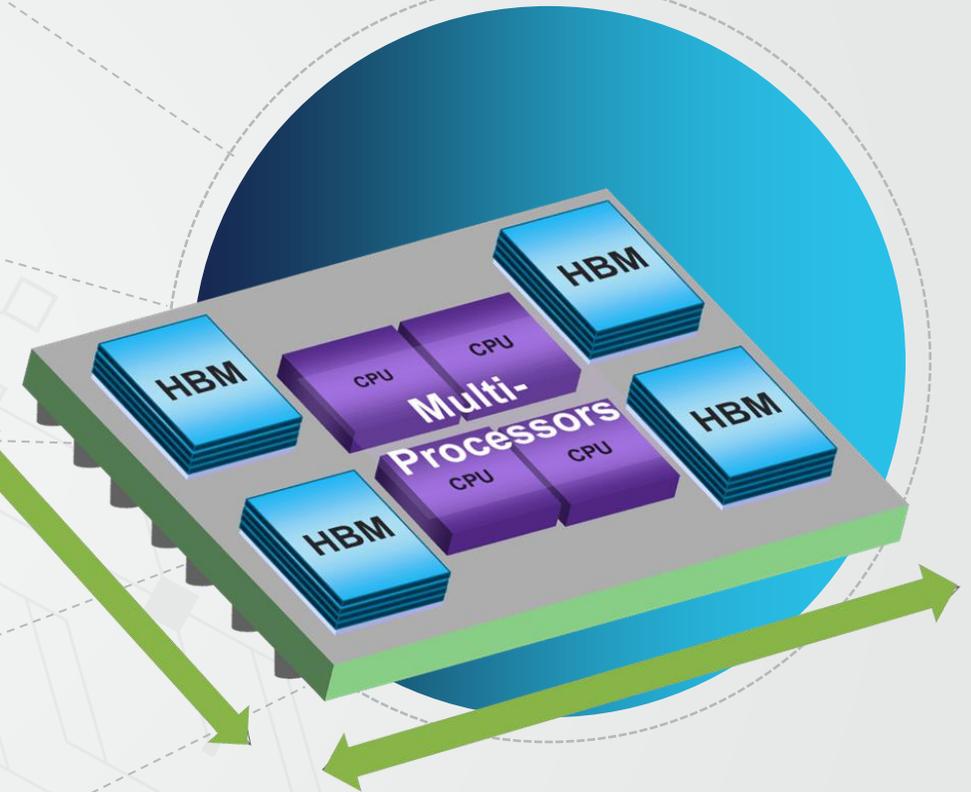
(HBM) High Bandwidth Memories

זיכרון רוחב פס גבוה, הוא ממשק זיכרון מחשב מהיר עבור זיכרון דינמי מוערם בתלת-ממד.



FC-BGA

מערך כדורי על מצע אריזת מוליכים למחצה בצפיפות גבוהה, המאפשר יותר פונקציות לשבבי LSI במהירות גבוהה.



מונחים מקצועיים הגדרות (המשך)



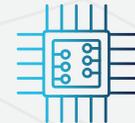
מארזי ECP

מארזים המכילים רכיבים של Power devices שמונחים על מצע אורגני קבור, החיבור בין הרכיבים נעשה על ידי רשת של מוליכים (RDL) במספר שכבות. המארז הוא חלק מסגמנט ה-Advanced Packaging והוא מוגן במספר פטנטים רשומים שאקסס רשמה



RDL

Redistribution layers - רשת של מוליכים דקים בין 2 ל 12 מיקרון שמחברת בין הרכיבים במספר שכבות של הולכה.



Via First

זו הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה באמיטק ומיושמת באקסס מיום הקמתה, בטכנולוגיה זו החיבור בין השכבות השונות נעשה דרך pillars שמיזשמים בתחילה ורק לאחר מכן מניחים את השכבה, להבדיל מהטכנולוגיה הרגילה בה חורי המעבר (Via) נקדחים ומצופים לאחר הנחת השכבה.



PMIC

Power management Interconnect – רכיבי Power Devices הצורכים זרמים גבוהים ונמצאים בסקלה הגבוהה של המחירים והאיכויות.



Pick&place

טכנולוגיה של השמת רכיבים על מצעים בצורה מאוד מדויקת ובתפוקה גבוהה.

